

■ 2020年8月29日 星期六

(上接A10版)

持着和客户的关系，不断更新客户需求，以保障设计生产的设备适销对路，本次募集资金用于研发投入具备技术可行性。

### 第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程修改情况、股东结构、高管人员结构及业务结构的变化情况

(一) 本次发行后公司业务及资产是否存在整合计划

本次发行完成后，公司不存在较大的业务和资产的整合计划，本次发行均围绕公司现有主营业务展开，公司业务结构不会产生较大变化，公司的盈利能力将有所提升，主营业务将进一步加强。

(二) 本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后，公司的股本总额将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。除此之外，本次发行不会对公司章程造成影响。

(三) 本次发行对股东结构的影响

本次发行完成后，公司的股本规模、股东结构及持股比例将发生变化，本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(四) 本次发行后对公司高管人员结构变动情况的影响

本次发行完成后，公司不会因本次发行而调整公司的高管人员。

(五) 本次发行对公司业务结构的影响

本次发行完成后，公司主营业务仍为半导体设备制造与销售，公司业务结构不会产生较大变化，公司的盈利能力将有所提升。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

(一) 本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产与净资产规模均大幅增加，公司的资金实力将进一步提升，公司资产负债结构更趋合理，有利于增强公司抵御财务风险的能力，为公司的长期持续发展提供良好的保障。

(二) 本次发行对公司盈利能力的影响

本次发行募集资金投资项目经营效益需要一定时间才能体现，因此本次发行后总股本增加会使公司每股收益被摊薄。本次募集资金投资项目到账后，将为公司主营业务发展提供长期发展资金，随着公司主营业务进一步做强做大，公司的盈利能力及经营业绩将显著提升。

(三) 本次发行对公司现金流量的影响

本次发行后，随着募集资金的到位，公司筹资活动产生的现金流将大幅增加；随着募集资金投资项目实施及效益的产生，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加；随着公司盈利能力及经营状况的完善，公司整体现金状况将得到进一步优化。

三、本次发行完成后，上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后，公司均无实际控制人，不存在同业竞争。同时，公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司关联交易的规则、政策和规定，确保上市公司依法运作，保护上市公司及其股东权益不会因此而受影响。本次发行将严格按照规程由上市公司董事会、股东大会进行审议，履行真实、准确、完整、及时的信息披露义务。

四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其他关联人占用的情形，上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情况

本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在为控股股东及其关联人违规提供担保的情形。

五、本次发行对公司负债情况的影响

本次发行完成后，公司的资产负债率将有所下降，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。公司的资产负债结构将更趋合理，抵御风险能力将进一步增强，符合公司全体股东的利益。

六、本次股票发行相关风险说明

投资者在评价公司本次向特定对象发行股票时，除预案提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：

(一) 核心竞争力风险

核心竞争力是企业在激烈市场竞争中赖以生存的差异化优势资源。目前，公司的核心竞争力主要体现在产品有关的技术优势及产品服务解决方案上。如果公司未能保持在市场中的技术领先地位，没有开拓其他具有竞争力的产品，不能提供满足客户需求的定制化服务，公司的核心竞争力将受到影响。

(二) 经营风险

近年来，全球半导体市场持续周期性波动态势给公司带来相应的经营风险。在行业景气度提升过程中，产业往往加大资本性支出，快速提升对相关设备的需求；在行业景气度下降过程中，半导体产能削减支出，进而对半导体设备的需求产生不利影响。公司的销售和盈利情况也会受到上述影响发生相应波动，带来相应的经营风险。

2、下游客户资产支付不达预期的风险

近年来，晶圆厂和LED芯片制造商审慎地进行扩产。不能排除下游晶圆厂和LED芯片制造商的后续投资不及预期，对相关设备的采购需求减弱，这将影响公司的订单量，进而对公司的业绩产生不利影响。

3、客户集中度较高的风险

经过多年的努力，公司已经成功进入了海内外知名芯片制造企业的供应链体系，公司客户结构得到不断优化，但客户集中度仍然较高。虽然公司与主要客户的合作关系较为稳固，且随着公司加大市场推广，公司的客户及产品结构日趋多元化，但客户集中度较高可能给公司的经营带来一定风险。如果主要客户的生产经营发生重大问题或财务状况出现恶化，将会影响公司的产品销售和应收账款的及时回收，产生不利影响。

4、全体员工持股带来的公司治理风险

作为科技创新型企业，公司秉承扁平化的全员激励原则，对不同层级员工均给予股权激励。员工持股计划涉及公司全体员工的利益，在员工持股计划限售期届满后，如何实现员工保持相当的激励水平，对公司的管理能力提出了一定的挑战。如果未来公司未能有效地管理员工持股计划，未能使员工持股计划持续作为员工整体薪酬的重要组成部分，将可能导致公司员工流失等治理风险。

5、政府补助与税收优惠政策变动的风险

公司自成立以来先后承担了多项国家和地方重大科研项目，2017年、2018年、2019年和2020年上半年度公司计入当期损益的政府补助金额为1.17亿元、1.70亿元、1.19亿元和1.24亿元。如果公司未来不能持续获得政府补助或政府补助显著降低，将对公司经营业绩产生不利影响。

公司为高新技术企业，报告期内公司享受高新技术企业15%所得税的优惠税率，如果国家上述税收优惠政策发生变化，或者公司未能持续获得高新技术企业资质认定，则可能面临因税收优惠取消或降低而导致盈利下滑的风险。

(三) 行业风险

1、行业政策变化风险

集成电路产业作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性产业。国家出台了一系列鼓励政策以推动我国集成电路及其装备制造业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力。若未来国家相关政策支持力度减弱，将对公司发展产生一定影响。

2、国际贸易摩擦加剧风险

近年来，国际贸易摩擦不断。中美贸易摩擦在众多国际贸易摩擦中备受关注。如果中美贸易摩擦继续深化，公司的生产运营将受到一定影响。

公司始终严格遵守中国和他国法律，一直保持与相关国家政府部门的及时沟通。公司拥有部分海外业务，存在一定的国际贸易摩擦风险。

(四) 募投及发行风险

本次向特定对象发行方案尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册，上交所是否审核通过、中国证监会能否同意注册，以及最终上交所审核通过、中国证监会同意注册的时间均存在不确定性。

2、募投项目支出增加导致利润下滑的风险

本次募集资金投资项目中固定资产投资规模金额较大。在项目建设达到预定可使用状态后，公司将新增较大金额的固定资产折旧。如公司募集的资金投资项目收益未能覆盖相关费用，则公司存在因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。

3、即期回报被摊薄的风险

本次向特定对象发行完成后，公司总资产和净资产规模将有较大幅度的增加，总股本亦相应增加，虽然本次募集资金到位后，公司将高效利用募集资金以提升公司运营能力和长期盈利能力，但由于受国家宏观经济及行业发展情况的影响，短期内公司盈利能力仍然存在很大的不确定性，因此本次向特定对象发行后公司股东即期回报将可能因本次发行而有所摊薄。

(五) 其他风险

1、知识产权风险

半导体设备行业是典型的技术密集型行业，为了保持技术优势和竞争力，防止技术外泄风险，已掌握先进技术和半导体设备企业通常会通过申请专利等方式设置较高的进入壁垒。公司一贯重视自主知识产权的研发，建立了科学的研发体系及知识产权保护体系，但仍不能排除与竞争对手产生知识产权纠纷，亦不能排除公司的知识产权被侵权，此类知识产权争端将对公司的正常经营活动产生不利影响。

公司在全球范围内销售产品，在多个国家或地区注册知识产权，但不同国家、不同的法律体系对知识产权的权利范围的解释和认定存在差异，若引发争议甚至诉讼将影响业务经营。

此外，产业链上下游供应商与客户的经营也可能受到知识产权争议、诉讼等因素影响，进而间接影响公司的正常生产经营。

2、人力资源风险

关键技术人员是公司生存和发展的关键，也是公司获得持续竞争优势的基础。公司已经通过全员持股方式，有效提高了关键技术人员和研发团队的忠诚度和凝聚力，但随着半导体设备行业对专业技术人员的需求与日俱增，人才竞争不断加剧，若公司不能提供更好的发展空间，更有竞争力的薪酬待遇及良好的研发条件，存在关键技术人才流失的风险。

公司通过员工持股安排等措施保证核心技术人员的稳定性，但公司仍存在核心技术人员流失的风险。公司核心技术人员的流失将可能对公司研发项目的实施和进程等方面造成一定影响。

公司拥有大量技术和管理资深专家，集聚并培养了一大批行业内顶尖的技术人才。但如果未能持续引进、培养、激励顶尖技术人才，公司将面临顶尖技术人才不足的风险，进而可能导致技术封锁，对公司创新方面有所落后。

### 3、投资风险

针对契合公司的中长期发展战略，有发展潜力的标的公司或部门，中微公司计划通过股权投资、并购等方式进行布局，以拓展公司业务领域，培育新的利润增长点，进一步提升公司防范市场波动风险并提升公司盈利能力。在进行投资和并购项目实施过程中，将面临投资风险及并购风险。

(一) 投资风险

基于产业支持政策、市场环境和发展趋势，公司经过尽职调查及可行性研究作出项目投资决策。公司投资项目的企业在后续发展过程中，可能面临产业政策变化、市场环境变化、产品技术水平不达预期等诸多不确定因素，可能导致其实际经营表现不达预期，进而导致投资项目的实际效益与预期结果存在较大差异。

(二) 并购风险

公司强调稳健发展，坚持实施内生性增长与外延式并购相结合的发展策略。虽然公司未来并购时将继续保持审慎原则，相对制定整合计划，防范并购风险，但若出现宏观经济波动、市场竞争加剧，被并购公司业绩低于预期或与预期反应不一致等情况，将对公司的经营业绩产生不利影响。

(三) 疫情风险

本次新冠肺炎疫情在全球范围蔓延，受疫情影响，全球经济面临较大下行压力，国内企业的健康发展也受到影响；疫情爆发对半导体行业上下游的影响仍在持续，市场对公司所处行业上下游的影响也传递至公司，可能对公司的经营造成一定影响。

(四) 研发投入不足导致技术被超越或替代的风险

本次发行完成后，公司主营业务仍为半导体设备制造与销售，公司业务结构不会产生较大变化，公司的盈利能力将有所提升。

(五) 本次发行对股东结构的影响

本次发行完成后，公司的股本规模、股东结构及持股比例将发生变化，本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(六) 本次发行后对公司高管人员结构变动情况的影响

本次发行完成后，公司不会因本次发行而调整公司的高管人员。

(七) 本次发行对公司业务结构的影响

本次发行完成后，公司主营业务仍为半导体设备制造与销售，公司业务结构不会产生较大变化，公司的盈利能力将有所提升。

(八) 本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

(九) 本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流将大幅增加；随着募集资金投资项目实施及效益的产生，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加；随着公司盈利能力及经营状况的完善，公司整体现金状况将得到进一步优化。

(十) 本次发行对公司现金流量的影响

本次发行后，随着募集资金的到位，公司筹资活动产生的现金流将大幅增加；随着募集资金投资项目实施及效益的产生，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加；随着公司盈利能力及经营状况的完善，公司整体现金状况将得到进一步优化。

(十一) 本次发行对股东结构的影响

本次发行完成后，公司的股本规模、股东结构及持股比例将发生变化，本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(十二) 本次发行后对公司高管人员结构变动情况的影响

本次发行完成后，公司不会因本次发行而调整公司的高管人员。

(十三) 本次发行对公司业务结构的影响

本次发行完成后，公司主营业务仍为半导体设备制造与销售，公司业务结构不会产生较大变化，公司的盈利能力将有所提升。

(十四) 本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

(十五) 本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流将大幅增加；随着募集资金投资项目实施及效益的产生，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加；随着公司盈利能力及经营状况的完善，公司整体现金状况将得到进一步优化。

(十六) 本次发行对公司现金流量的影响

本次发行后，随着募集资金的到位，公司筹资活动产生的现金流将大幅增加；随着募集资金投资项目实施及效益的产生，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加；随着公司盈利能力及经营状况的完善，公司整体现金状况将得到进一步优化。

(十七) 本次发行对股东结构的影响

本次发行完成后，公司的股本规模、股东结构及持股比例将发生变化，本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(十八) 本次发行后对公司高管人员结构变动情况的影响

本次发行完成后，公司不会因本次发行而调整公司的高管人员。

(十九) 本次发行对公司业务结构的影响

本次发行完成后，公司主营业务仍为半导体设备制造与销售，公司业务结构不会产生较大变化，公司的盈利能力将有所提升。

(二十) 本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

(二十一) 本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流将大幅增加；随着募集资金投资项目实施及效益的产生，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加；随着公司盈利能力及经营状况的完善，公司整体现金状况将得到进一步优化。

(二十二) 本次发行对公司现金流量的影响

本次发行后，随着募集资金的到位，公司筹资活动产生的现金流将大幅增加；随着募集资金投资项目实施及效益的产生，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加；随着公司盈利能力及经营状况的完善，公司整体现金状况将得到进一步优化。

(二十三) 本次发行对股东结构的影响

本次发行完成后，公司的股本规模、股东结构及持股比例将发生变化，本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(二十四) 本次发行后对公司高管人员结构变动情况的影响

本次发行完成后，公司不会因本次发行而调整公司的高管人员。

(二十五) 本次发行对公司业务结构的影响

本次发行完成后，公司主营业务仍为半导体设备制造与销售，公司业务结构不会产生较大变化，公司的盈利能力将有所提升。

(二十六) 本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

(二十七) 本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流将大幅增加；随着募集资金投资项目实施及效益的产生，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加；随着公司盈利能力及经营状况的完善，公司整体现金状况将得到进一步优化。

(二十八) 本次发行对公司现金流量的影响

本次发行后，随着募集资金的到位，公司筹资活动产生的现金流将大幅增加；随着募集资金投资项目实施及效益的产生，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加；随着公司盈利能力及经营状况的完善，公司整体现金状况将得到进一步优化。

(二十九) 本次发行对股东结构的影响

本次发行完成后，公司的股本规模、股东结构及持股比例将发生变化，本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(三十) 本次发行后对公司高管人员结构变动情况的影响

本次发行完成后，公司不会因本次发行而调整公司的高管人员。

(三十一) 本次发行对公司业务结构的影响

本次发行完成后，公司主营业务仍为半导体设备制造与销售，公司业务结构不会产生较大变化，公司的盈利能力将有所提升。

(三十二) 本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

(三十三) 本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流将大幅增加；随着募集资金投资项目实施及效益的产生，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加；随着公司盈利能力及经营状况的完善，公司整体现金状况将得到进一步优化。

(三十四) 本次发行对公司现金流量的影响

本次发行后，随着募集资金的到位，公司筹资活动产生的现金流将大幅增加；随着募集资金投资项目实施及效益的产生，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加；随着公司盈利能力